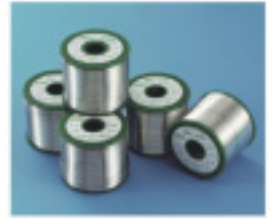


# 松脂焊锡

Flux-cored Solder Wire

类型 Type	免清洗高活性型 No-Clean High Activity				免清洗锡渣透明型 No-clean Clear Residue	普通型 General Type
	JISZ 3283 CLASS AA			JISZ 3283 CLASS A	JIS Z3283 Class A	JIS Z3283 Class B
助焊剂 Flux type	010	011	020	210	110M	203
合金 Alloy	SN100C • SN96CI • SN97C, etc.					
Flux含量 Flux content%	3.0、4.0			2.5	2.0	
卤素含量 Halide content%	≤ 0.05	≤ 0.04	0	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.9
水溶阻抗 (Ω m) Resistivity of water extract	≥ 2000	≥ 2000	≥ 1000	≥ 500	≥ 1000	≥ 500
表面绝缘抗阻值 SIP(Ω) Comb Pattern形基板 Comb Pattern II	≥ 1×10 <sup>10</sup>	≥ 1×10 <sup>10</sup>	≥ 1×10 <sup>10</sup>	≥ 1×10 <sup>9</sup>	≥ 1×10 <sup>9</sup>	≥ 1×10 <sup>9</sup>
扩散率 Spread factor%	≥ 75	≥ 80	≥ 80	≥ 70	≥ 70	≥ 75
线直径 Diameter	0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 mm					

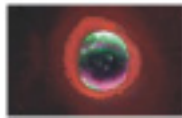


试验方法 Test method: JIS Z 3197-1999相当

扩散率: 合金、Flux%, 线径等不同数据会有变化 (使用焊锡SN100C)

\* Spread is dependent on alloy composition, flux % and diameter. (used Alloy: SN100C at 300°C)

- 焊锡扩散实验 Spreading test



SN100C(011)4%

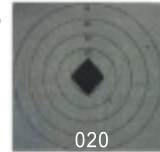


SN100C(011)3%

- 飞散实验(与本公司020相比) Less Spattering 020type

锡球飞散数

020	2个
JIS B class相当品	30个



020



JIS B class相当品

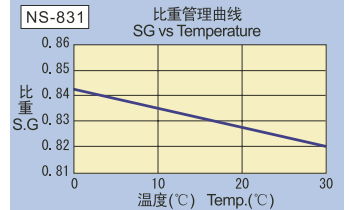
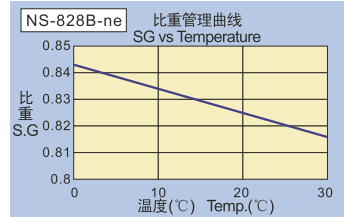
## 助焊剂

Flux

对应无铅焊锡的高活性，高信赖性助焊剂，用喷雾器涂敷焊锡流动性通孔爬升都良好。

Both of NS-828B-ne and NS-824 are a robust, high activity flux with all the properties necessary to get reliable joints in lead-free soldering.

项目 Item	NS-828B-ne	NS-831	试验方法 Test method
flux类型 Flux type	无光泽 Matt finish	无光泽 Matt finish	Visual observation
比重 S.G. 20°C	0.826	0.828	JIS Z 3197 6.4
固体含量 Solid content mass%	17	14.5	145°C 15min.
卤素含量 Halide content %	0.08	0.07	JIS Z 3197 6.5
铜板腐蚀试验 Corrosion test on copper plate	无腐蚀 Passed	无腐蚀 Passed	JIS Z 3197 6.6.1
绝缘抵抗值 SIR Ω	初期值 Initial value	≥ 1.0×10 <sup>13</sup>	JIS Z 3197 6.8
	1000hrs后 After 1000hrs	≥ 1.0×10 <sup>11</sup>	
电压印加耐湿性 Ω Electromigration	初期值 Initial value	≥ 1.0×10 <sup>13</sup>	JIS Z 3197 6.9
	1000hrs后 After 1000hrs	≥ 1.0×10 <sup>11</sup>	
扩散率 Spread factor %	≥ 85	≥ 75	JIS Z 3197 6.10
酸值 Acid value mgKOH/g	12	34	JIS-K-59025.4
闪点 Flash point °C	32	12	
用途 Application	发泡・浸渍・手刷镀数 for foaming, dipping, brushing	喷雾・发泡・浸渍・手刷镀数 for spray, foaming, dipping, brushing	



- 在通孔上的湿润爬升比较



外径2.0mm内径1.0mm



NS-831



旧产品

## 用于BGA・CSP焊锡球

BGA・CSP Sphere

SN100C • SN96CI • SN97C

直径为0.1~0.9mm(±10 μ m) 助焊剂使用RM-5型

0.1~0.9mm diameter(±10 μ m) For best soldering use the compatible flux RM-5

用于BGA・CSP锡球的flux

RM-5 Flux for BGA/CSP

项目 Item	RM-5	试验方法 Test method
卤素含量 Chloride content %	0.02±0.005	JIS Z 3197 6.5
扩散率 Spread factor %	≥ 80%	JIS Z 3197 6.10
绝缘抵抗值 SIR Ω	初期值 Initial value	≥ 1.0×10 <sup>13</sup>
	96hrs后 After 96hrs heat & humidity	≥ 1.0×10 <sup>11</sup>
外加电压耐湿性 Ω Electromigration	初期值 Initial value	≥ 1.0×10 <sup>13</sup>
	96hrs后 After 96hrs heat & humidity	≥ 1.0×10 <sup>11</sup>
用途 Application	印刷镀数敷用 for printing	

